



社外取締役
土屋 奈生

2018年6月の株主総会で選任いただき、社外取締役として職務遂行させていただいております。近年はコーポレートガバナンスの重要性、更にもその中で独立社外取締役の役割の重要性も言われております。株主の皆様をはじめとする当社のステークホルダーの皆様の利益となるよう、当社の企業価値を高めるために、独立社外の立場からできることは何かを考え、客観的な目線での意見、提案を心がけてまいりました。

目まぐるしく変わる国際情勢など、しばらくは必ずしも順調とは言えない環境に置かれることもあるかと思いますが、その中でも生産性改善など必要な施策が軸をしっかりとって実施され、更により会社として飛躍できるよう、微力ながら努めてまいります。

引き続きご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

コーポレートデータ (2019年3月31日現在)

会社概要	
商号	株式会社メイコー
設立	1975年11月25日
資本金	12,888百万円
従業員数	11,899名(連結) (国内815名・海外11,084名)
主な事業内容	電子回路基板等の設計、製造および販売ならびにこれらの付随業務に関する電子関連事業

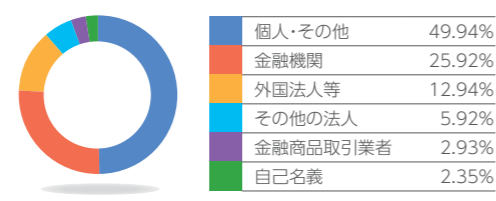
役員	
代表取締役社長執行役員	名屋 佑一郎
取締役専務執行役員	平山 隆英
取締役専務執行役員	篠崎 政邦
取締役常務執行役員	松田 孝広
取締役常務執行役員	和田 純也
取締役	申 允浩
取締役	土屋 奈生
常勤監査役	伊豫本 齊
監査役	原田 隆
監査役	佐藤 孝幸

関連会社	
株式会社山形メイコー	電子関連事業
株式会社メイコーテック	電子関連事業
株式会社メイコーテクノ	電子関連事業
名幸電子(広州南沙)有限公司	電子関連事業
名幸電子(武漢)有限公司	電子関連事業
名幸電子香港有限公司	電子関連事業
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd.	電子関連事業
Meiko Electronics America, Inc.	電子関連事業
Meiko Electronics Europe GmbH	電子関連事業

株式情報		
発行可能株式総数	70,000,000株	
発行済株式の総数	26,173,942株 (自己株式 629,378株を除く)	
株主数	6,910名	
大株主		
株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
名屋 佑一郎	4,703	17.97
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,997	7.63
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,123	4.29
株式会社ゆうちょ銀行	780	2.98
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS	755	2.88
名幸興産株式会社	608	2.32
有限会社ユーホー	521	1.99
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)	437	1.67
名屋 精一	435	1.66
野村信託銀行株式会社(投信口)	430	1.64

※当社は、自己株式 629,378株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

所有者別株式分布状況(普通株式)



株主メモ	
事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(郵便物送付先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎0120-782-031 投資その他の資産
上場証券取引所	東京証券取引所 JASDAQ(スタンダード)
公告の方法	電子公告により当社ウェブサイトに掲載 https://www.meiko-elec.com/lir/pa.html ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載

株式に関するお問合せ

- 住所変更、配当金受取り方法の変更等のお手続きは、お取引の証券会社にお問合せください。
- 証券会社の口座をご利用でない株主様、未払配当金のお手続きは、上記三井住友信託銀行証券代行部にお問合せください。



MEIKO REPORT

第44期 株主通信

(2018年4月1日から2019年3月31日)

証券コード：6787

株式会社メイコー

財務ハイライト

売上高

118,910 百万円

営業利益

8,926 百万円

親会社株主に帰属する当期純利益

6,743 百万円

連結貸借対照表

	前期末 2018年3月31日現在	当期末 2019年3月31日現在
資産の部		
流動資産	56,369	56,021
固定資産	53,946	64,634
有形固定資産	49,732	58,553
無形固定資産	210	269
投資その他の資産	4,003	5,811
資産合計	110,316	120,655
負債の部		
流動負債	48,924	47,932
固定負債	28,349	39,135
負債合計	77,274	87,068
純資産の部		
株主資本	29,638	30,446
資本金	12,888	12,888
資本剰余金	11,745	6,464
利益剰余金	5,400	11,489
自己株式	△396	△396
その他の包括利益累計額	3,403	3,141
その他有価証券評価差額金	21	△65
繰延ヘッジ損益	298	183
為替換算調整勘定	3,512	3,322
退職給付に係る調整累計額	△428	△298
純資産合計	33,042	33,587
負債純資産合計	110,316	120,655

連結損益計算書

	前期(累計) 2017年4月1日～ 2018年3月31日	当期(累計) 2018年4月1日～ 2019年3月31日
売上高	108,542	118,910
売上原価	90,115	98,862
売上総利益	18,426	20,048
販売費及び一般管理費	10,969	11,121
営業利益	7,457	8,926
営業外収益	1,081	1,752
営業外費用	3,742	2,067
経常利益	4,795	8,610
特別利益	344	1
特別損失	296	750
税金等調整前当期純利益	4,843	7,862
法人税等	497	1,119
当期純利益	4,346	6,743
非支配株主に帰属する当期純損失(△)	△26	—
親会社株主に帰属する当期純利益	4,373	6,743

連結キャッシュ・フロー計算書

	前期(累計) 2017年4月1日～ 2018年3月31日	当期(累計) 2018年4月1日～ 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,429	11,466
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,868	△17,292
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,530	1,956
現金及び現金同等物に係る換算差額	△35	98
現金及び現金同等物の期首残高	17,196	15,190
現金及び現金同等物の期末残高	15,190	11,419

財務のポイント

●連結損益計算書

車載向け基板分野は、需要増加の流れを背景に6層板以上の貫通板、ビルドアップ基板や放熱基板が増加する傾向が顕著になりました。スマートフォン向け基板分野は、需要の低下がみられましたが、通期では前期並みとなりました。ビルドアップ基板全体としては、その他分野のIoTモジュールとAI家電向け基板の受注を取り込むことにより好調に推移いたしました。その結果、当期の連結業績は、売上高1,189億10百万円(前期比9.6%増)、営業利益89億26百万円(同19.7%増)、経常利益86億10百万円(同79.6%増)、親会社株主に帰属する当期純利益67億43百万円(同54.2%増)となり、売上高、各利益において過去最高を更新いたしました。

●連結貸借対照表

総資産は1,206億55百万円となり、前期末に比べ103億39百万円増加しました。これは流動資産において、現金及び預金が37億64百万円減少、受取手形及び売掛金が9億22百万円増加、たな卸資産が16億77百万円増加、固定資産において、有形固定資産が88億20百万円増加、投資その他の資産が18億7百万円増加したことによるものです。純資産は335億87百万円となり、前期末に比べ5億45百万円増加しました。これは資本剰余金がA種優先株式の取得により52億81百万円減少、利益剰余金が60億89百万円増加したことによるものです。



本社 〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上5-14-15 ホームページ <https://www.meiko-elec.com/>
TEL: 0467 (76) 6001 (大代表)

見直しに関する注意事項

本報告書に記載されている情報につきましては、当社の計画、業績など将来の見直しに関する記述が含まれており、これらの記述は、その時点で入手可能な情報および当社が合理的であると判断する一定の前提条件に基づいて行われます。実際の業績は、さまざまな要素により、これらと異なる結果となり得ることをご承知おきください。



この冊子は環境保全のため、植物油インキとFSC®認証紙を使用しています。見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。2019年3月期の業績についてご報告申し上げます。

代表取締役社長 **名屋 佑一郎**

2018年度 連結実績

	2018年度		前年比	
	実績	実績	増減額	増減率
売上高	1,085	1,189	103	9.6%
営業利益	74	89	14	19.7%
経常利益	48	86	38	79.6%
親会社株主に帰属する当期純利益	43	67	23	54.2%
為替	YEN/USD	110.66	111.04	

2018年度 製品別収益

	2017年度累計		2018年度累計		前年比	
	売上	営業利益	売上	営業利益	売上	営業利益
車載	483	37	547	39	64	2
スマートフォン	324	27	325	38	1	11
その他	278	10	317	12	39	2
合計	1,085	74	1,189	89	104	15

2019年度 連結業績予想

	2019年度		前年比	
	実績	計画	増減額	増減率
売上高	1,189	1,200	10	0.9%
営業利益	89	75	-14	-16.0%
経常利益	86	63	-23	-26.8%
親会社株主に帰属する当期純利益	67	53	-14	-21.4%
為替	YEN/USD	111.04	111.00	

2019年度 製品別収益予想

	2018年度累計		2019年度計画		前年比	
	売上	営業利益	売上	営業利益	売上	営業利益
車載	547	39	553	40	6	1
スマートフォン	325	38	274	22	-51	-16
その他	317	12	373	13	56	1
合計	1,189	89	1,200	75	11	-14

通期の業績について

当連結会計年度における電子部品業界は、米中貿易摩擦などを背景に、中国の景気低迷などの影響がグローバルに広がりました。自動車市場では、電装化の流れにより基板の使用量は増加する傾向にあります。スマートフォン市場においても在庫調整による需要の低迷が進行しました。スマートフォン市場においても在庫調整と需要の減速がみられました。一方で、中国政府による景気対策もあり徐々に需要が回復してまいりました。

このような状況の中、当社グループでも第4四半期業績に大きな影響を受けましたが、通期では売上高、利益の各項目において過去最高を更新いたしました。車載向け基板は、需要増加の流れを背景に、6層板以上の貫通板、ビルドアップ基板や放熱基板が増加する傾向が顕著になりました。スマートフォン向け基板は、需要の低下がみられましたが通期では前年度並みとなりました。ビルドアップ基板全体としては、その他分野のIoTモジュールとAI家電向け基板の受注を取り込むことにより好調に推移いたしました。

次期の見通しについて

次期の当社グループの販売は、車載向け基板では第4四半期の需要の悪化と、在庫調整からの回復が見込まれるのに加えて、電装化の進行などによる需要の回復を見込んでおります。スマートフォン向け基板では、足元の需要は回復しておりますが、ビルドアップ基板分野としては、成長が見込める分野に受注を徐々にシフトしております。IoTモジュールとAI家電向け基板は販売が引き続き好調に推移するとともに、同基板を使用するアミューズメント向け基板の販売が拡大する見込みとなっており、全体としては増収を見込んでおります。

収益面においては、製品販売価格の下落やベトナム第3工場の固定費の増加、資源価格や為替の変動が懸念されますが、自動化投資や構造改革を通じて更なる経営体質の改善強化と、ベトナム第3工場の早期立ち上げを図ってまいります。

投資計画と財務体質の強化について

2018年度は、ベトナム新工場の建設などにより、150億円の投資を行いました。ベトナム新工場は3か年で生産規模が倍増することとなります。2019年度の投資につきましては、通期で125億円の投資を行う計画としております。主な投資としては、引き続きベトナム新工場の生産設備導入と、その他工場の自動化を中心に投資を推進してまいります。また、2020年度以降は投資を抑制し有利子負債の圧縮を図ることいたしました。これにより、自己資本比率、売上高有利子負債比率を改善する計画です。

ベトナム新工場の状況について

ベトナム新工場は、2019年7月より順次生産を立ち上げていく予定です。

第1工場ではFPC基板とEMSの生産を拡大いたします。FPC基板は、車載向けに高耐熱・低膨張材に対するモノづくり、5G通信向けでは低伝送損失、多層FPCの量産が求められております。この工場ではFPC基板生産と部品実装・組立工場が隣接して、一貫生産が可能となっております。次世代製品にFPC基板とEMSのシナジー効果を創出してまいります。

第2工場では車載分野を中心に生産規模の拡大を推進してまいります。

第3工場はビルドアップ基板専用工場となります。

5G通信とMSAP基板

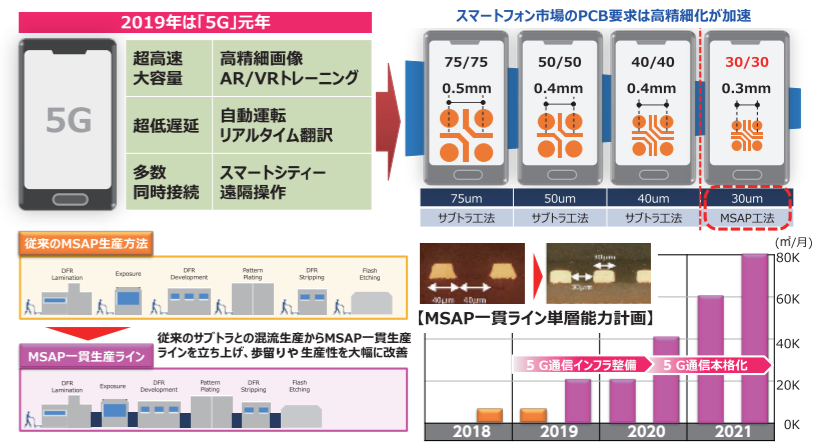
2019年度は「5G」元年となります。社会インフラとして5G通信が整備され、高速な通信により様々な変革が想定されています。スマートフォンは、高精細かつ大容量のデータのやり取りを行います。通信モジュールが遅延のないネットワーク上で自動運転やリアルタイム翻訳、遠隔地医療などを実現していくこととなります。

こうした環境を支えるのがMSAP工法で生産されるプリント基板です。プリント基板の仕様はこれまで以上に高精細、高周波対応が求められます。

当社ではMSAP工法のプリント基板を生産しておりますが、収益性を高め量産化を実現するため、MSAP基板の一貫生産ラインを構築いたします。これにより歩留りや生産性を大幅に改善しつつ拡大する需要に対応してまいります。

配当金について

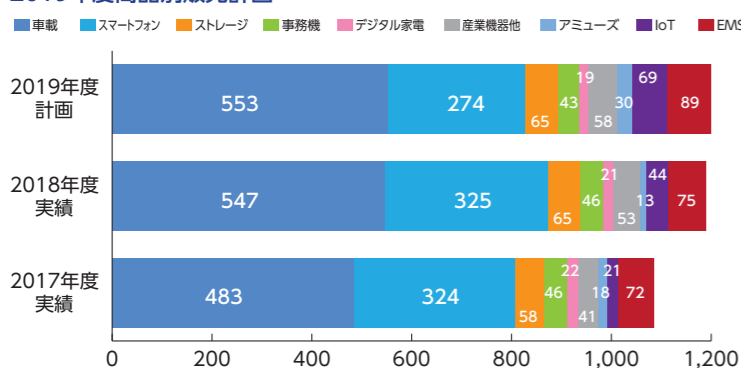
当社は、株主の皆様に対する利益向上を経営の重点課題の一つとし、利益配分については利益額を増加させ、配当額を増加することとしております。当期の剰余金の配当は、期末配当を1株当たり20円とし中間配当と合わせ年間で35円といたしました。株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーのご支援、ご期待に応えるべく、改善のための各々の施策に全力で取り組み、業績と企業価値の向上に努めてまいります。今後とも一層のご支援・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



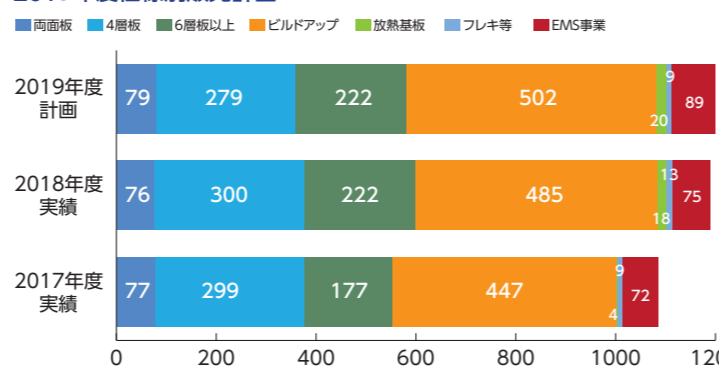
生産能力拡大計画		2018	2019	2020	2021
第1工場	FPC (EMS)	20 (12)	25 (16)	35 (22)	45 (28)
第2工場	車載貫通板 車載ビルドアップ	40 (5)	80 (10)	120 (20)	150 (30)
第3工場	スマホビルドアップ (MSAP) 車載開発品	70 (-)	75 (20)	80 (40)	85 (80)

※カッコ内は上記生産量の内数(EMSはライン本数)

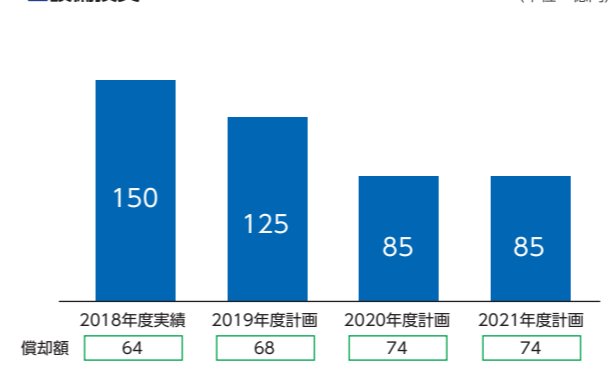
2019年度商品別販売計画



2019年度仕様別販売計画



設備投資



配当の推移

